

【応募要領】

半導体産業技術交流会 提案企業の募集について

本資料は、シャープ福山レーザー(株)をニーズ発信企業とする半導体産業技術交流会（以下「技術交流会 2025 in シャープ福山レーザー」という。）へのエントリーについてのご案内です。積極的なご提案をお待ちしております。

なお、ご提案頂いた内容は、技術交流会とその後のマッチング以外の目的で利用することはありませんので、可能な範囲で詳細にご記入下さい。

また、皆様の連絡先は、関連事業（セミナーやワークショップのご案内など）に使用させて頂く場合がございますが、それ以外でご本人の同意なく第三者に開示・提供することはございません。

1. 概要

中国地域半導体関連産業振興協議会では、ニーズを有する大手半導体関連企業（以下、「ニーズ発信企業」とする。）に対して技術を持つ企業が提案を行うことで、相互の交流・連携の「きっかけ」づくりをサポートするための商談イベント「技術交流会」を令和7年度に5回開催します。

その第一弾として、シャープ福山レーザー(株)をニーズ発信企業とする「技術交流会 2025 in シャープ福山レーザー」を開催します。

つきましては、ニーズに対する技術提案を行う企業等（以下、「提案企業」とする。）の募集を行いますので、本要領をご確認いただき、是非、応募していただきますよう、ご案内申し上げます。

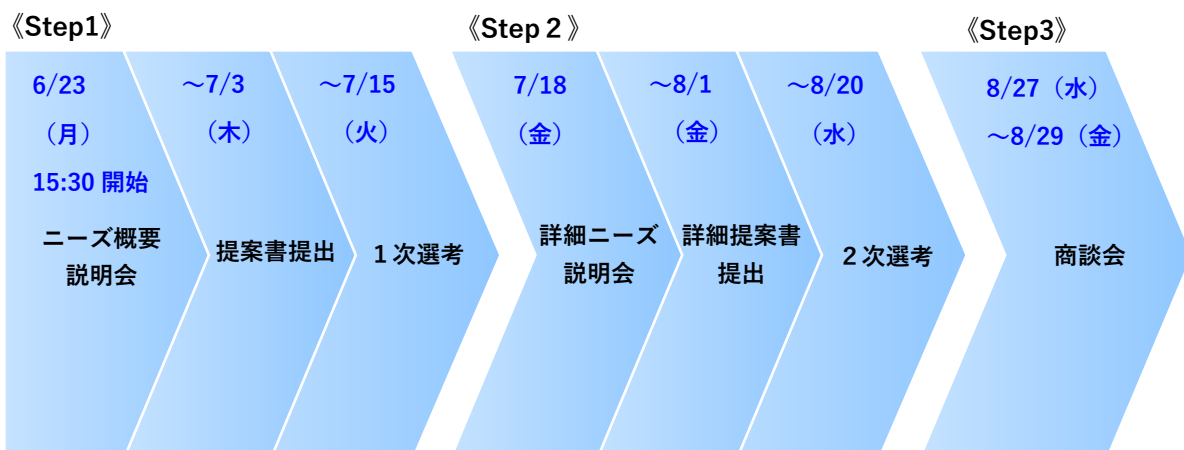
8月27日（水）～8月29日（金）（予定）の商談会に参加していただくためには、下図のとおり、Step1とStep2の手続きをパスしていただく必要があります。

Step1では、6月23日（月）15:30に開催する「ニーズ概要説明会」（オンライン開催）を踏まえて、7月3日（木）までに提案書を提出して1次選考を受けていただきます。

1次選考をパスされた場合は、Step2として、7月18日（金）に開催する「詳細ニーズ説明会」（オンライン開催）を踏まえて、8月1日（金）までに詳細提案書を提出して2次選考を受けていただきます。

2次選考をパスされた場合は、Step3として、8月27日（水）～8月29日（金）の商談会に参加していただくことができます。

なお、ご提案の際には、別紙「ニーズ発信企業のニーズ等の情報」も参考にしてください。



2. 参加申込み対象

提案企業として参加申込みが可能な企業等は、以下の国が関係する半導体関連の協議会・コンソーシアム（以下、「地域コンソ」とする。）の会員です。現時点で、何れの地域コンソの会員でもない場合は、事前に入会等の手続きをお願いいたします。

※各地域コンソには入会要件が設定されている場合がございますので事務局にご確認ください。なお、貴社の本社、工場、事業所等がある地域に地域コンソが設立されていない場合や入会が難しい場合等は、中国地域半導体関連産業振興協議会にご入会ください。全国の企業等を対象に会員を募集しています。

※技術交流会に関する問合せは「5. 技術交流会に関する問い合わせ先」までご連絡ください。

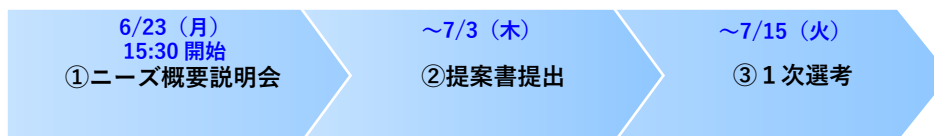
■ 中国地域半導体関連産業振興協議会 https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html 【問い合わせ先】 中国経済産業局 地域経済部 半導体関連産業室 電話：082-224-5709 E-mail：bzl-monozukuri02@meti.go.jp
■ 北海道半導体人材育成等推進協議会 https://www.hkd.meti.go.jp/hokcm/semiconductor/index.htm
■ 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム（T-Seeds） https://t-seeds.jp/
■ 関東半導体人材育成等連絡会議 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/index.html
■ 中部地域半導体人材育成等連絡協議会 https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html
■ 九州半導体人材育成等コンソーシアム https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/electronics.html
■ 九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ） https://siiq.or.jp

3. 全体の流れ

ここからは、Step1～Step3 の順に、全体の流れを説明します。

(1) Step1 について

《Step1》



①「ニーズ概要説明会」

6月23日(月)15:30に、オンラインで「ニーズ概要説明会」を開催します。URL等は以下のとおりです。

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI4MmI2ZjMtNmNhZC00YjA3LWEyYjYtODY5ZjIyMTVINTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22b6d94148-69a6-487a-8a69-88236d09260a%22%2c%22id%22%3a%22e5be1e9f-e3dc-4758-8c9e-8eaadd38ab57%22%7d

ID: 446 287 256 509 5 パスコード: QK7QW7gp

本説明会では、ニーズ発信企業であるシャープ福山レーザ(株)から、同社のニーズ（技術交流会 2025 in シャープ福山レーザでの提案を希望する内容）の概要を説明します。「ニーズ概要説明会」に参加しなくても、エントリーシートを提出できますが、同社のニーズに適した提案をしていただくためにも、是非、参加してください。

②「提案書提出」

別紙の「提案書」を記載して、7月3日(木)までに、次の応募専用サイトから事務局宛てに送信してください。提案書は、ニーズ発信企業による選考資料ですので、可能な範囲で具体的な記入をお願いします。

提出物：提案書

作成要領：i 提出物は提案書のみです。付属資料がある場合は、提案書の巻末にページを追加して、付属資料を貼り付けて提出してください。

ii 提案書のデータ容量は5MB以内とし、ファイル名は「技術交流会 2025 in SFL 提案書(〇〇社).docx」にしてください。応募専用サイトは、5MBを超える書類を受信できませんので、宜しくお願いいたします。

iii 提案書はWORDファイルで提出してください(PDF等に変換しないでください)。

iv 応募要領(別紙)に記載されたニーズに対応していない提案も可能ですが、ニーズに対応した提案を中心に選考作業が進む可能性が高いことをご了承ください。

v 提案書は、機密情報を含まない公開可能情報のみで作成してください。

提出期間：2025年6月23日(月)～7月3日(木)17:00(必着)

提出先：応募専用サイトから送信してください。

<https://hirogin-areadesign.smkgtg.jp/public/seminar/view/2641>

送付頂いた資料は、ニーズ発信企業の他、地域コンソに提出することがあります。予めご了承ください。

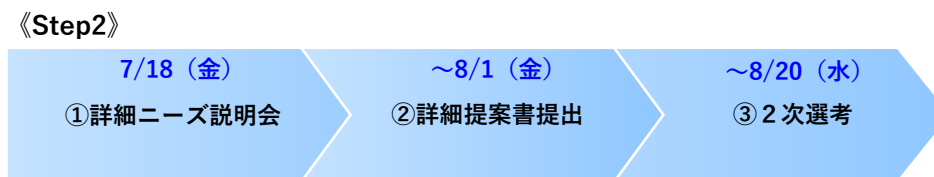


③ 1次選考

シャープ福山レーザ(株)が提案書を確認し、Step2に進む提案企業を選考します。選考の結果、提案書を提出していただいたにも関わらず、Step2に進むことができない場合がある点ご了承ください。

選考結果は、提案書を提出していただいた全ての企業等に、7月15日(火)までに通知する予定です。なお、選考理由に関するお問い合わせには応じかねます。

(2) Step2 について



①「詳細ニーズ説明会」

7月18日（金）に、オンラインで「詳細ニーズ説明会」を開催します。開催時間や URL 等は後日ご連絡します。

本説明会では、ニーズ発信企業であるシャープ福山レーザー(株)から、同社のニーズ（技術交流会 2025 in シャープ福山レーザーでの提案を希望する内容）について、Step1 の「ニーズ概要説明会」よりも掘り下げた内容で説明します。「詳細ニーズ説明会」に参加申込していただく場合は、説明会の内容について別添秘密保持条項を順守していただくことを前提といたしますので、その旨についてご了承いただいた上でご参加ください。

「詳細ニーズ説明会」に参加しなくても、「詳細提案書」を提出できますが、同社のニーズに適した提案をしていただくためにも、是非、参加してください。

②「詳細提案書提出」

別紙の「詳細提案書」を記載して、8月1日（金）までに、後日ご連絡する応募専用サイトから事務局宛てに送信してください。詳細提案書は、ニーズ発信企業による選考資料ですので、可能な範囲で具体的な記入をお願いします。

提出物：詳細提案書

作成要領：i 提出物は詳細提案書のみです。付属資料がある場合は、詳細提案書の巻末にページを追加して、付属資料を貼り付けて提出してください。

ii 詳細提案書のデータ容量は 5MB 以内とし、ファイル名は「技術交流会 2025 in SFL 詳細提案書（〇〇社）.docx」にしてください。応募専用サイトは、5MBを超える書類を受信できませんので、宜しくお願いいたします。

iii 詳細提案書は WORD ファイルで提出してください（PDF 等に変換しないでください）。

iv 応募要領（別紙）に記載されたニーズに対応していない提案も可能ですが、ニーズに対応した提案を中心に選考作業が進む可能性が高いことをご了承ください。

v 詳細提案書は、機密情報を含まない公開可能情報のみで作成してください。

提出期間：2025 年 7 月 18 日（金）～8 月 1 日（金）17：00（必着）

提出先：応募専用サイトから送信してください。URL は後日ご連絡します。

送付頂いた資料は、ニーズ発信企業の他、地域コンソに提出することがあります。予めご了承ください。

③ 2次選考

シャープ福山レーザー(株)が詳細提案書を確認し、Step3 の商談会に進む企業を選考します。選考の結果、提案企業として詳細提案書を提出していただいたにもかかわらず、商談会に進むことができない場合がある点ご了承ください。

選考結果は、詳細提案書を提出していただいた全ての企業に、8月20日（水）までに通知する予定

です。なお、選考理由に関するお問い合わせには応じかねます。

（３）Step3 について

前日の 1 次・2 次選考をパスした提案企業に対して、事務局から技術交流会および名刺交換会の詳細な案内（商談時間、会場等）を連絡します。

①技術交流会

日時：2025 年 8 月 27 日（水）～8 月 29 日（金）（予定）

場所：シャープ福山レーザー(株)本社 （広島県福山市大門町旭 1 番地）



商談方法：提案企業一社あたり 50 分程度（質疑応答時間を含む）

※担当者全員が会場参加できない方はオンライン（Teams）での参加も可能です。

※商談は個室で実施します。

※商談の個室に、中国地域半導体産業振興協議会の事務局が同席する場合があります。

参加費：無料

②名刺交換会

技術交流会の終了後、技術交流会当日の関係者（参加企業等）を対象に、任意参加型の名刺交換会を実施します。詳細は、後日ご連絡します。

4. その他

技術交流会の後日、商談結果のアンケートを取らせていただきますので、ご協力をお願いします。

5. 技術交流会に関する問い合わせ先

技術交流会業務受託機関：ひろぎんエリアデザイン(株)

（E-Mail）semicon@hirogin.co.jp

（TEL）080-9954-7833 もしくは 080-9955-6549

※可能な限りメールでのお問い合わせをお願いいたします。

技術交流会は、技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）の「地域における先端半導体に資する人材育成推進事業」の一環で実施いたします。